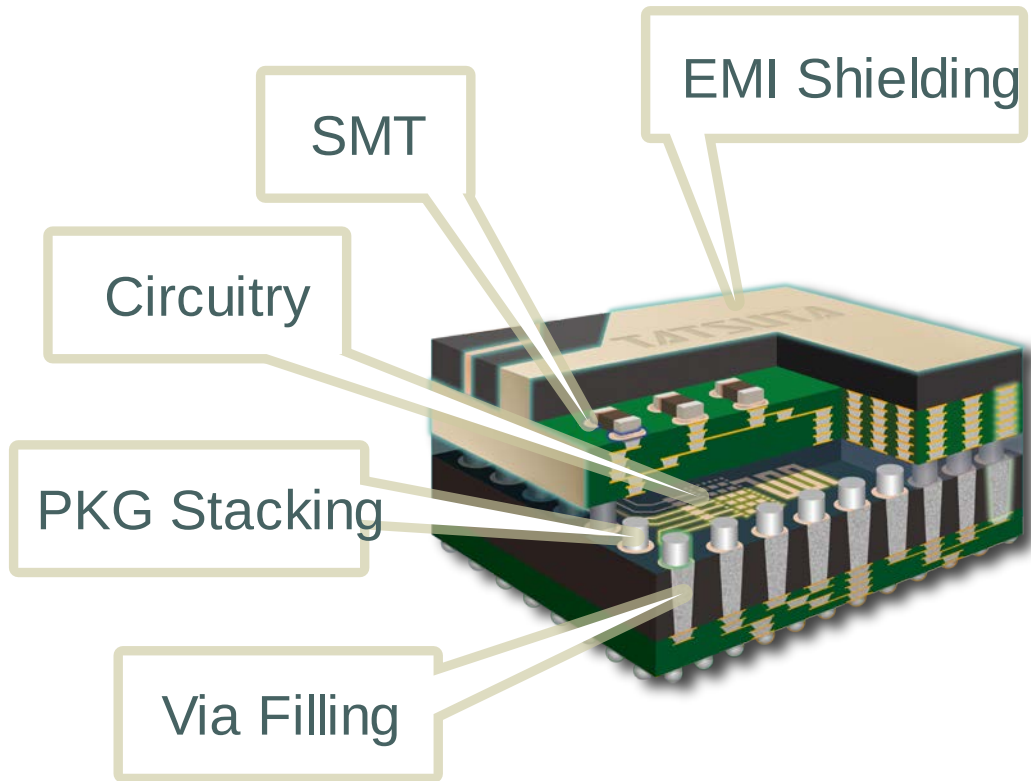
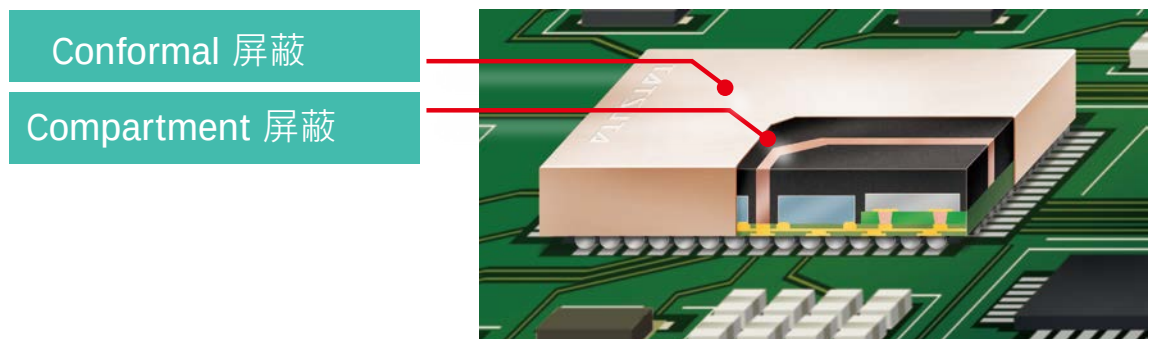


半導體相關應用



EMI 屏蔽

TATSUTA 有兩種工法: 噴塗和印刷. 基本上要走整個銅膏包覆(Conformal屏蔽)會用噴塗的工法下去進行. 而銅膏填溝槽(Compartment屏蔽)的部分則會以印刷的工法下去進行填溝槽之作業.



■產品特徵

Conformal shielding

- 擁有優秀屏蔽之特性<70db以上: Coating厚度10um、1GHz-10GHz>
- 對多種基材都有良好的接著性

Line up
AE5000 Series

Compartment shielding

- 擁有優秀屏蔽之特性<over 60dB in the range of 1GHz to 10GHz的範圍測量下、擁有60dB以上的屏蔽效果 >
- 在使用真空印刷機的狀況下、溝槽的寬度介於100um也可以有效的填覆

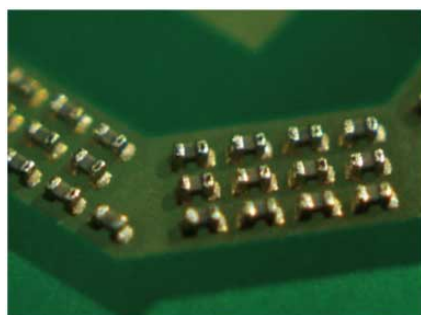
Line up
AE1244

SMT

TATSUTA的導電銅膏也可對應低溫SMT製程.



可在含有線路的PET膜上進行SMT製程



可對應0201尺寸的元件

■ 產品特徵

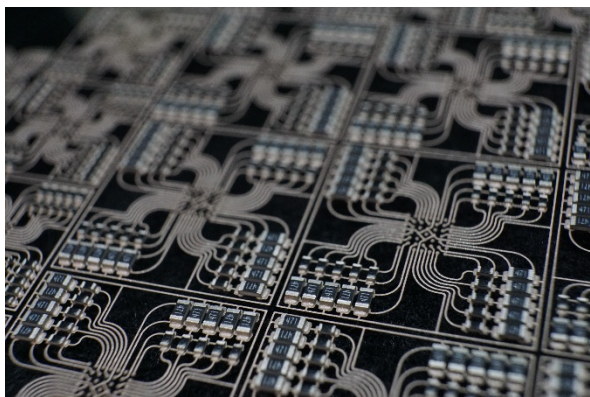
- 在 120–160deg的低溫下也有良好的接著強度
- 於鉛錫相同或更好的接著強度
- 對多種基材都有良好的接著性

Line up
AE8006

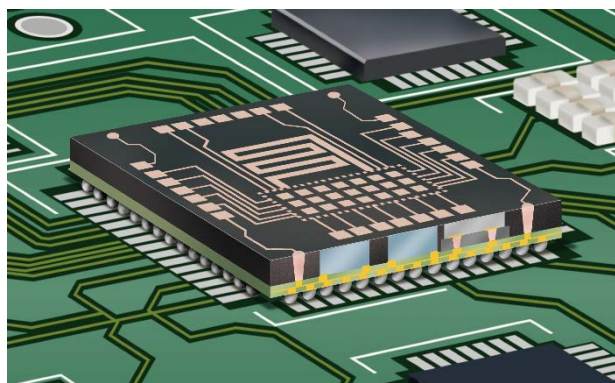
Circuitry

TATSUTA的低溫導電銅膏可應用在不耐熱及多種不同的基材上。
如PET、COP、Molding Resin、LCP、Wafer 和其他多種基材。

可印刷線路在glass interposer



直接印刷線路在PKG上



■ 產品特徵

- 因低溫固化的特性、可對應耐熱度低的基材
(100deg.C x 60min)
- 可直接在銅膏上作化鍍
- 擁有穩定的導電特性
- 可對應多種可彎曲基材

Line up
SW series

PKG Stacking

TATSUTA的導電銅膏可應用在Package stacking相關之應用, 可有效應用在Package堆疊層間來幫助整體有效散熱. 藉由銅膏製程來達到薄型化且更有效率應用在設計上.

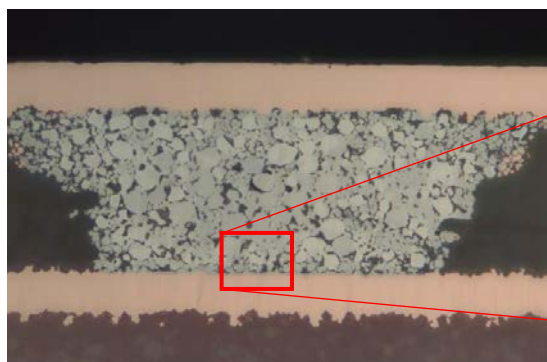
Via Filling

關於銅膏填孔製程、此應用已長達30年之久. 主要填孔應用銅膏分為兩大類:

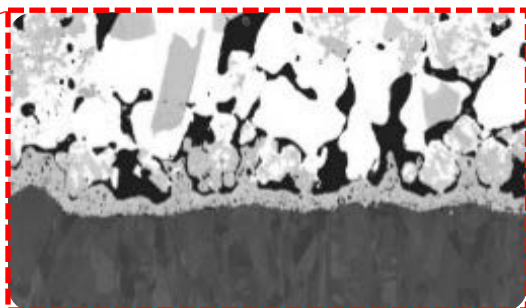
MP系列銅膏

AE系列銅膏

MP 系列



IMC Layer

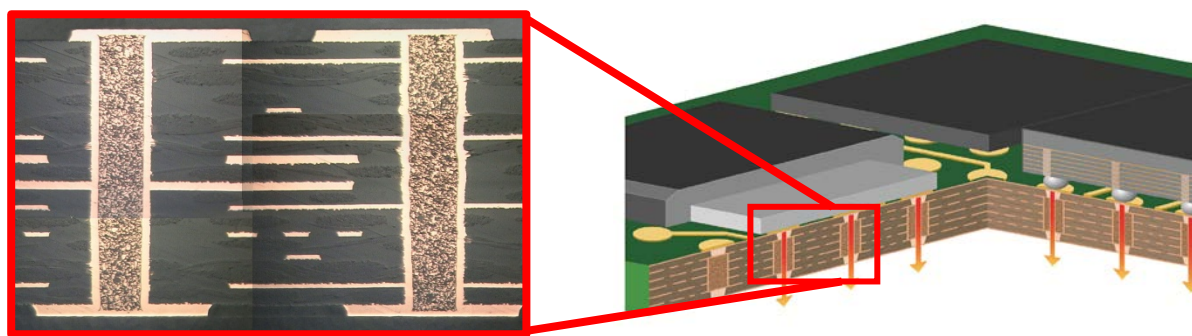


MP系列銅膏是經由低溫反映和高溫反映金屬材料結合我做成的導電銅膏。其特殊特性可藉由低於**160°C**的熱壓製程讓銅膏和銅箔形成合金層，讓其特性可承受至**260°C**的反應溫度表現其高信賴性。

■ 產品特徵

- 銅膏與銅箔合金化來達到良好的導通和信賴性
- 可提高基板耐熱性和散熱性

AE 系列



AE 系列銅膏是以銀粒子或是銀包銅粒子結合而成的導電銅膏。藉由靠溫度反應的結合劑、讓金屬粒子能有效的提供導電和導熱之特性。

■ 產品特徵

- 擁有優秀的印刷特性.<無氣泡>
- 可對應多種基材.
- 具備高耐熱和高散熱之特性.

TATSUTA is a Japanese functional paste supplier and has developed paste for semiconductor and electronics, automotive industry.

TATSUTA
www.tatsuta.com